

● USP-12B01パッケージ許容損失

USP-12B01パッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

1.測定条件(参考データ)

測定条件: 基板実装状態

雰囲気: 自然対流

実装: Pbフリーはんだ

実装基板: 銅箔4層基板40mm×40mm(片面1600mm²)
に対して銅箔面積

1層目: ランド及び配線パターンのみ

2層目: 約50%_1st放熱板と接続

3層目: 約50%_2nd放熱板と接続

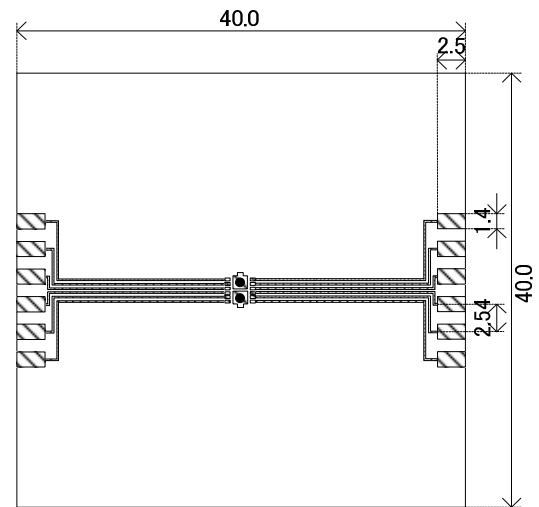
4層目: 無し

基板材質: ガラスエポキシ(FR-4)

板厚: 1.6mm

スルーホール: ホール径 0.8mm 2個

(放熱板TAB1つに対して1個)



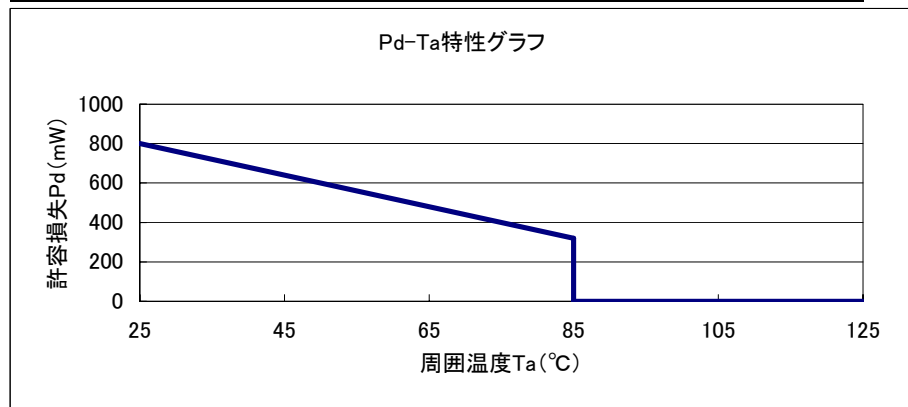
評価基板レイアウト(単位:mm)

2.許容損失-周囲温度特性

1) 1chのみ発熱

基板実装($T_{jmax} = 125^{\circ}\text{C}$)

周囲温度(°C)	許容損失Pd(mW)	熱抵抗(°C/W)
25	800	125.00
85	320	



2) 2ch同時発熱

基板実装($T_{jmax} = 125^{\circ}\text{C}$)

周囲温度(°C)	許容損失Pd(mW)	熱抵抗(°C/W)
25	600	166.67
85	240	

